# 技术创新需求调查表

|  |
| --- |
| **企业信息** |
| 企业名称 | 扬州虹扬科技发展有限公司 | 机构代码 |  |
| 区 域 | 邗江 | 联系人 | 吴海霞 | 电话 | 15995137911 |
| 行业领域 | 能源动力 | 产业领域 | 能源动力 |
| 经济规模 | 无 | 人员规模 | 无 |
| 需求信息 |
| 需求名称 | 消除GPP芯片电泳后表面玻璃点 |
| 技术需求情况说明 | 技术需求类别 | ☑技术研发（关键、核心技术）□产品研发（产品升级、新产品研发）□技术改造（设备、研发生产条件）□技术配套（技术、产品等配套合作） |
| 技术需求简述 | 消除GPP芯片电泳后表面玻璃点 |
|  | 技术需求详述 | （包括主要技术、条件、成熟度、成本等指标）1、芯片氧化层致密度的提升，既能在芯片电泳时起到有效屏蔽的作用，且在后续湿法去氧化层时又能较快速的去除，减少湿法对沟槽玻璃的损伤。2、提升光刻胶对芯片表面覆盖的均匀性，增强胶膜的抗腐蚀性，使得芯片在沟槽腐蚀时表面的氧化层得到有效保护，避免钻蚀现象。3、提高芯片表面平整度，减少芯片表面凹坑。 |
| 现有基础情况 | （企业已经开展的工作、所处阶段、投入资金和人力、仪器设备、生产条件等）我司目前自制GPP芯片，玻璃钝化方式采用的是电泳法，芯片沟槽内经电泳后会附着玻璃粉，而芯片表面利用SiO2的屏蔽作用，避免玻璃粉附着。在芯片批量生产中，个别片的部分区域表面，在电泳后出现表面附着玻璃粉，形成点状，经玻璃烧结后，变成坚固的玻璃点附于芯片表面，对芯片外观以及组装焊接造成负面影响 |
| 产学研合作要求 | 简要描述 | （希望与哪类高校、科研院所开展产学研合作，共建创新载体，以及对专家及团队所属领域和水平的要求）与哈尔滨理工大学、西安电子科技大学合作 |
| 合作方式 |  □技术转让 □技术入股 ☑联合开发 □委托研发  □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |
| 其他需求 | □技术转移 □研发费用加计扣除 □知识产权 □科技金融 □检验检测 □质量体系 □行业政策 □科技政策 □招标采购 □产品/服务市场占有率分析 □市场前景分析 □企业发展战略咨询 □其他 |
| **管理信息** |
| 同意公开需求信息 |  ☑是 □否 □部分公开(说明） |
| 同意接受专家服务 |  ☑是 □否 |
| 同意参与对解决方案的筛选评价 |  ☑是□否 |
| 同意对优秀解决方案给予奖励 |  □是，金额万元。（奖金仅用作奖励现场参赛者，不作为技术转让、技术许可或其他独占性合作的前提条件） □否 法人代表： 年 月 日 |